



Smart Retail
Digital Signage
Interactive Kiosks
Hospitality

NEXCOM



NDiS・Neu-X・AEdge-X[®] series

Interactive Signage Platform Product Selection Guide
スマートリテール・サイネージソリューション
セレクトカタログ Vol. 7

2025.03 | NEXCOM Japan www.nexcom-jp.com

●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2024年3月現在のものです。

本製品に関するお問い合わせは



株式会社ネクスコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : <https://www.nexcom-jp.com>

Neu-X

ラインナップ充実
低価格なスマートシティコントローラ
バリューモデルも展開中

Neu-X60 p.8



Neu-X102-N97 p.10



Neu-X104 p.7



Neu-X304 p.12



Xシリーズは、低価格を実現した産業用ファンレス・スマートシティ・コントローラです。デジタルサイネージからゲートウェイまで、インドアユースに適しています。

In-Door

Neu-Xシリーズ

エッジコンピューティングシステム



XPPCシリーズ

ワイドタッチパネルPC



AIEdge-X®シリーズ

AI エッジコンピュータ



NDiS Bシリーズ

インダストリアル
ビジュアルエンジン



HPPCシリーズ

4:3 タッチパネルPC
高輝度



受注生産

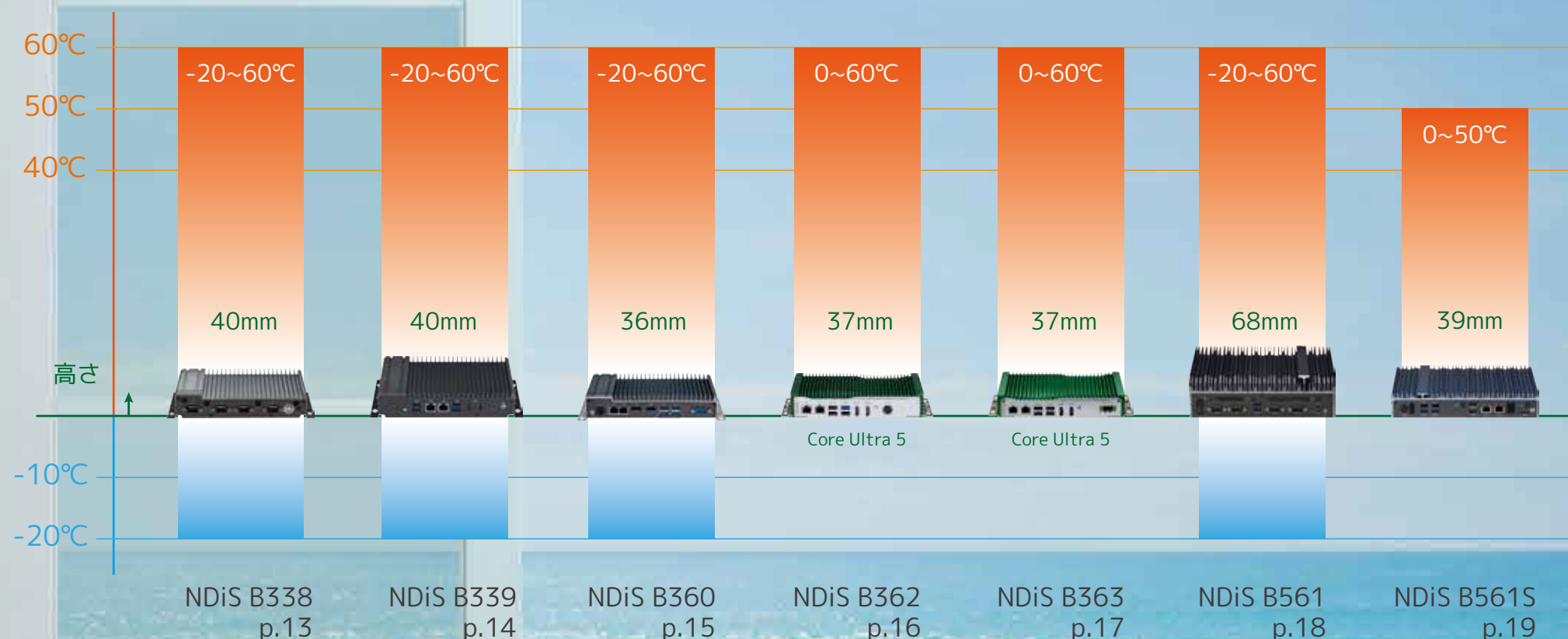
Neu-X302
Neu-X303mini
NDiS V1100
AIEdge-X300
AIEdge-X500
Neu-X101-6C-DC



Semi Out-Door

NDiS

ネクスコムフラグシップ高性能 STB
より信頼性の高いビジュアルソリューションを実現



NDiSシリーズは、2009年のデビュー以来16年に渡り、世界中で運用されているネクスコムのデジタルサイネージ用STBです。高信頼性をポリシーとし、より広い動作温度範囲や設置しやすい薄型のボディなど、インドアはもちろんアウトドアユースにも適しています。駅や空港をはじめとする公共機関やリテールマーケットなど、設置環境を選びません。

NEXCOM導入事例1

デンマーク

XPPC 16-200 パネル PC : 浚渫（しゅんせつ）装置のための信頼できる選択

背景

地球表面の約 71% を覆う水は、遠く離れた都市や国々の間での、輸送や貿易を可能にするとともに、水生の動植物にとって住みやすい環境を提供しています。しかし、時間の経過とともに、自然に堆積が起こり、水路の水深が減少することで、輸送や貿易が脅かされるだけでなく、植物や野生生物の生息環境にも影響を及ぼす可能性があります。

幸いなことに、浚渫機器を使用すれば、吸引管を用いてこの堆積物を取り除き、安全な航行や生息環境を回復することが可能です。しかし、この作業には課題も伴います。作業員はプロセス全体を慎重に監視し、吸引管の位置を正確に調整して、堆積物を効果的に除去する必要があります。

課題

機器は、効率的かつ信頼性の高い表示機能とデータ伝送機能を備えている必要があり、作業中に塵や水しぶきにさらされても、安

定して動作し続ける必要があります。また、厳しい環境条件に耐えるだけでなく、機器は更に、リアルタイムでデータを更新できる機能を備え、円滑な運用を確保することが求められます。

ソリューション

ある浚渫業者は、これらの作業を確実に遂行するためのソリューションを求めて NEXCOM に相談しました。NEXCOM は、その優れた産業用コンピュータ製品の中から、強力で効率的なパネル PC である XPPC 16-200 を提案しました。

XPPC 16-200 は、緻密な設計により環境によるダメージのリスクを軽減し、浚渫事業者が求める信頼性と安定性を提供します。IP65 規格に準拠しており、塵や水しぶきといった浚渫作業で避けられない条件に対して、高い保護性能を発揮します。更に、光学結合技術を採用し、高湿度環境下でも優れた視認性を実現します。このパネル PC は、完全密閉構造とガラス表面加工による耐久性を備えており、クリーニングも容易です。これにより、デバイスの寿命を延ばすだけでなく、保守の必要性を減らし、機器の故障や汚染による潜在的なダウンタイムを最小限に抑えます。堅牢な外装と、高度に適応した構造を備えたこのパネル PC は、過酷な作業環境でも非常に優れたパフォーマンスを発揮し、浚渫作業の長期的な運用安定性を確保します。

XPPC 16-200 は、吸引管からのリアルタイムデータを処理・表示するために、第 11 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載しています。更に i5 モデルには、Intel® Iris® Xe グラフィックスが搭載されており、より鮮明で視覚的に優れたプレゼンテーションが可能です。また、システムアーキテクチャは、クライアントのニーズに最適な I/O 構成を提供しています。浚渫吸引管の計測用に COM (RS485) x1、アラームシステム用に USB x1、データ転送と管理用に LAN x1 を装備しており、これもまた、NEXCOM がクライアントの要件に的確に対応できることを証明しています。



NEXCOM導入事例2

オーストラリア

NDiS B338 組込みシステム： 革新的なセルフ型 健康モニタリングキオスクの成功事例

背景

APAC (アジア太平洋) 地域の活気あふれる都市で、市民の健康と福祉へのアプローチに革命が起きています。ウェルネスの象徴ともいえる、最先端のヘルスチェックキオスクが登場しました。このキオスクは、NEXCOM の NDiS B338 組込みシステムを搭載し、誰でも簡単にアクセスできる、便利で包括的なヘルスチェックを提供するよう設計されています。

課題

都市部から遠隔地にまで広がる人口増加に対応するため、より効率的で手軽に健康をモニタリングできる方法が、早急に求められていました。従来の方法は時間がかかり、多くの場合、医療施設への訪問が必要で、多くの人にとってハードルが高いものでした。

ソリューション

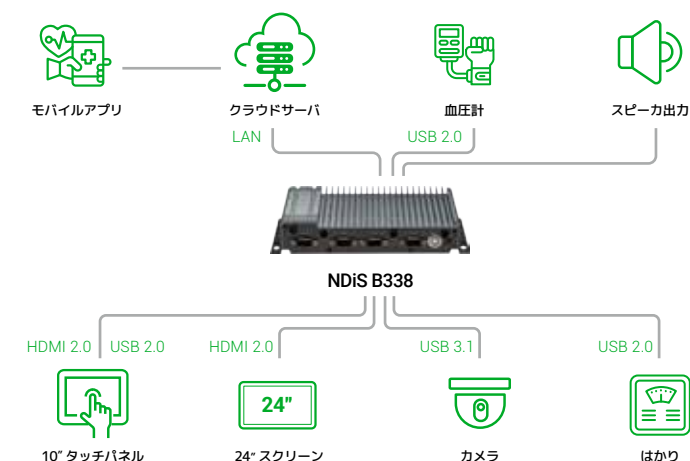
その答えは、NEXCOM の堅牢な NDiS B338 組込みシステムを基盤とした、最先端のセルフサービスによるヘルスチェックキオスクの形で実現しました。このキオスクは、市場の複雑なニーズに応えるよう設計されており、HDMI 2.0 出力 x3、USB ポート x6、シリアルポート x4、およびオーディオ出力を備え、柔軟かつユーザフレンドリーなインターフェースを提供し、シームレスな統合を実現します。

テクノロジー

NDiS B338 は、Intel® Celeron® J6412 クアッドコア高性能プロセッサを搭載し、-20°C ~ 60°C までの広範囲な動作温度をサポートしています。HDMI 2.0 出力は、高精細な映像を提供し、インタラクティブな指示や教育的なコンテンツを通じて、ユーザーを健康チェックのプロセスに導きます。複数の USB ポートは、血圧測定や血糖値チェックなど、さまざまな健康モニタリングデバイスを接続することで、包括的な健康診断を可能にします。さらに、シリアルポートは、追加の周辺機器とのシームレスな接続を提供し、スピーカー出力により、明瞭な音声指示を提供することで、視覚障害のあるユーザを含むすべての人にとって使いやすいキオスクを実現します。

導入効果

このセルフサービス型ヘルスチェックキオスクは、導入以来、広く普及しており、その使いやすさと、健康状態を即座に把握できる点でユーザから高い評価を受けています。このシステムは、個人が自分の健康に積極的に取り組むことを可能にするだけでなく、医療提供者の負担を軽減することにも貢献しています。



Neu-X102-N50 エッジ PC：
観光体験を革新するリバーサイド革命の実現

ロンドンの賑やかなテムズ川沿いには、洗練されたデジタルトートメが静かな案内役として立ち並び、訪れる人々を迎えています。これらのモダンな案内板は、リアルタイムの船のスケジュールや天気情報、地域の詳細情報を表示し、リバーサイドでの体験一新しています。このスマートシティの進化の中心にあるのが、NEXCOMの強力な Neu-X102-N50 であり、これら革新的な情報ハブを支える原動力です。

これらの革新的な情報トータルは、市内のウォーターフロントの観光地全体で、観光客の体験に革命をもたらしています。その外観は地域の美観に合わせて異なるものの、中核を担うのは、NEXCOM の強力なエッジコンピューティングシステム、Neu-X102-N50 です。

これらのトータムの中心には、屋外用途向けに特化した優れた技術が組み込まれています。Neu-X102-N50 は、Intel® Processor N50 と最大 16GB の RAM を搭載しており、厳しい環境でもスムーズなパフォーマンスを実現します。また、-5°C ~ 50°C までの動作温度範囲に対応しており、多様な気候条件でも適応可能です。

Neu-X102-N50 の卓越した技術力は、プロセッサにとどまりません。最大 2 つの HDMI ポートをサポートし、鮮やかなコンテンツを再生して、人目を引くビジュアルで観光客を引き付け、情報を伝えることができます。更に、M.2 および mPCIe スロットを備え、ストレージの拡張や LTE および Wi-Fi 6 機能に対応し、リッチコンテンツの保存と超高



速ワイヤレス接続を実現します。これらの機能により、トーテムは、高い利用者数を誇るエリアでも容易に対応できる、包括的な情報ハブとして機能します。

観光客は、鮮やかな 32 インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて、スケジュールや天気情報以外にも豊富な情報にアクセスできます。地元の観光スポットやおすすめの飲食店、さらにはリアルタイムの大気質データまで、指先ひとつで確認できます。このエッジコンピューティングシステムは、デュアル 2.5GbE LAN ポートと 4G LTE 接続を備えており、常に最新の情報を提供します。また、USB 光センサと COM ポートを通じて、明るさを自動調整することができ、さまざまな光の条件下でも情報を読み取りやすくするとともに、システムの省エネにも貢献しており、現代の都市の持続可能性の目標にも合致した設計が実現されています。

トータムのオペレーターにとって、リモート管理機能は重要な要素です。LAN や LTE を通じて、コンテンツの更新やシステムのメンテナンスを行うことができるため、運用コストを大幅に削減し、効率的な管理を行うことができます。

これらのエッジコンピューティングシステムは、観光客の体験を向上させるだけでなく、都市計画や観光管理に役立つ貴重なデータインサイトを提供します。Neu-X102-N50 は、USB 3.2 の帯域幅ポートに接続したカメラにより、データのスムーズな取り込みと伝送を可能にし、観光客の流れをリアルタイムでモニタリング・分析します。この高度な機能により、都市計画担当者や観光関係者は、リソース配分の最適化や都市のモビリティ向上のための情報に基づいた意思決定を行うことができ、観光客や地元住民の体験をシームレスかつ快適なものにします。

Neu-X102-N50は、都市の景観に自然に溶け込みながら、観光客や地元住民にとって不可欠なサービスを提供する、スマートシティ技術の大きな進歩を象徴しています。都市のより多くのエリアがこの技術を採用するにつれて、観光地との関わり方や、その行動に変革がもたらされ、訪れる人々が、情報をうまく活用しながら、より積極的に豊かな体験ができる、新時代の都市観光の到来が期待されます。

スマートシティコントローラ
Neu-X シリーズ バリュークラス

Comming Soon

低消費電力で GPU の性能が向上したスマートシティコントローラ



Neu-X104 は、Intel 新型 CPU (Twin Lake) を採用し、性能と消費電力の最適化によりバランスの良いパフォーマンスを実現しました。効率性を追求した E コアのみを搭載することにより、CPU の性能が向上し Neu-X102 に比べ 1 ランク上のパフォーマンスを実現しました。



Neu-X104-N150 :
Intel® Processor N150 (Quad Core, 最大3.6 GHz)
Neu-X104-N250 :
Intel® Processor N250 (Quad Core, 最大3.8 GHz)
Neu-X104-N355 :
Intel® Core™ 3 Processor N355 (8 Core, 最大3.9 GHz)

- Intel® UHD graphics
- DDR4 SO-DIMMスロット x 1 最大16GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.2 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- 12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 Neu-X104-N150/N250 : 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)

重量 0.85 kg

動作温度範囲 -5℃～ 50℃

外形寸法 Neu-X104-N355 : 180mm (W) x 106mm (D) x 40mm (H)

重量 0.9 kg



Neu-X60

超低価格で Intel® Processor N50 を搭載したシンプルバリューモデル



Neu-X60 は、低価格、小型、必要最低限の機能を搭載したファンレスエッジコンピュータです。手のひらサイズのファンレスエッジコンピューティングシステムは、デジタルサイネージ、産業用コントローラシステム、IoT ゲートウェイ、セルフサービスキiosk、屋内アプリケーション、小売機器など、ほとんどのアプリケーションをサポートします。

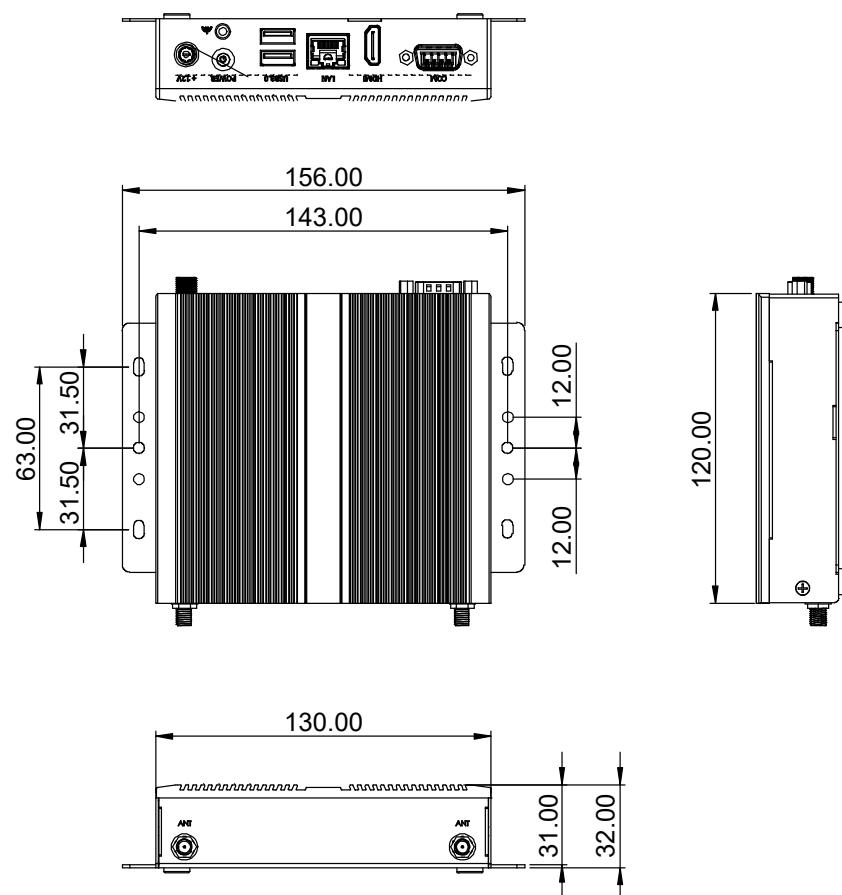


- Intel® Processor N50 (Dual Core, 最大3.4 GHz)
- Intel® UHD Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1
- RS232/422/485 x 1, LAN x 1
- USB3.2 x 2, HDMI 2.0 x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- 12V DC / 50W ACアダプタ付属

外形寸法 130mm (W) x 120mm (D) x 32mm (H)

重量 0.54 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C



Neu-X101 シリーズ

ベストセラー Celeron® J3455 搭載で豊富なオプション 使いやすくなったスマートシティコントローラ



Neu-X101 は、コンパクトサイズで、放熱効果を高め、USB ポート x4 や、Nano サイズ SIM、オーディオ端子 (オプション)、LTE (オプション)などを追加しました。CPUはIntel® Celeron® J3455で、さまざまな用途に導入可能なスマートシティコントローラです。

Neu-X101 シリーズ共通仕様

- Intel® Celeron® J3455 (Quad Core, 1.5GHz)
- Intel® HD Graphics 500
- DDR3L SO-DIMMスロット x 1 最大8GB
- LAN x 2, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2
- HDMI 1.4b x 2, M.2 x 1 (SSD)

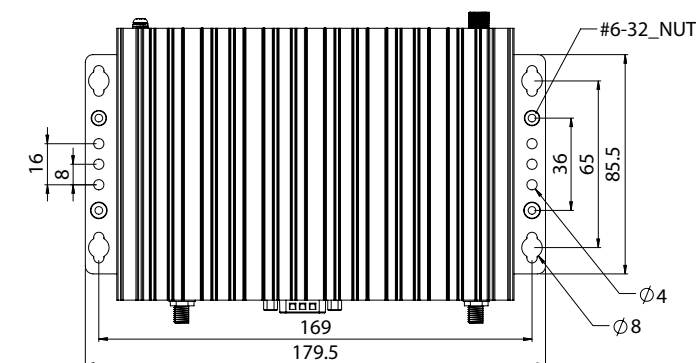
動作温度範囲 -5°C ~ 50°C



Neu-X101

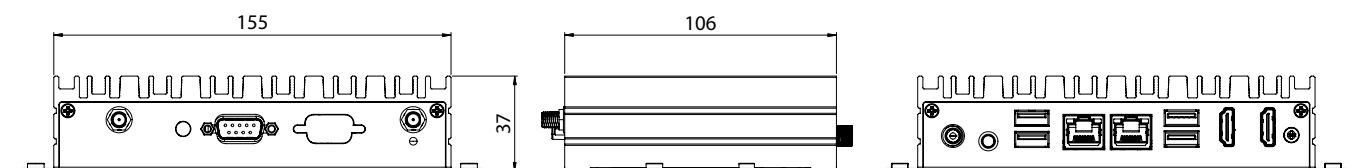


Neu-X101 背面



- Neu-X101 :
- RS232/422/485 x 1
 - Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
 - ロック付きDC ジャック
 - 12V DC / 60W ACアダプタ付属
 - 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H) 1.0 kg

- Neu-X101 ハードウェア追加オプション(背面) :
- 2 nd COM x 1 (RS232)
 - オーディオ (Line-out)



Neu-X101-6C-DC ODM 製品

Neu-X101 をベースとした通信機能を追加 (COMx6) した ODM 製品。RS232Cx6、RS485x5 + RS232C、RS422 等、各ポートをカスタマイズ可能。DC 入力コネクタは産業向けターミナルブロックを採用し、電源供給が容易になりました。さらに 12V-24V のワイドレンジ DC 入力をサポートします。ODM 製品のため最低発注数がありますのでお問い合わせください。



Neu-X101-6C-DC



Neu-X101-6C-DC 背面

- Neu-X101-6C-DC :
- RS232 x 1, RS485 x 4, RS232/422/485 x 1
 - 2極端子ブロック
 - 9~24V DC入力
 - 155mm (W) x 121mm (D) x 44mm (H) 1.1 kg

Neu-X102 シリーズ

新型 Intel プロセッサ搭載 用途に合わせた 3 タイプのスマートシティコントローラ

Neu-X102 シリーズは、Neu-X101 のデザインを継承し、Intel® Processor N50、N97、Core i3 の CPU を搭載。低消費電力・低価格で大幅にアップグレードされました。高速な N97/Core i3 CPU を搭載したコントローラは、大型ヒートシンクによる効率的な放熱設計により、高性能を活かした IoT ゲートウェイとして最適なパフォーマンスを提供します。



Neu-X102-N50

Neu-X102-N97/Neu-X102-i3



Neu-X102-N50 背面

Neu-X102-N97/Neu-X102-i3 背面

Neu-X102-N50 :
Intel® Processor N50 (Dual Core, 最大3.4 GHz)
Neu-X102-N97 :
Intel® Processor N97 (Quad Core, 最大3.6 GHz)
Neu-X102-i3 :
Intel® Core™ i3-N305 (8 Core, 最大3.8 GHz)

- Intel® UHD graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大16GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.2 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIM スロット x 1
- 12V DC / 60W AC アダプタ付属

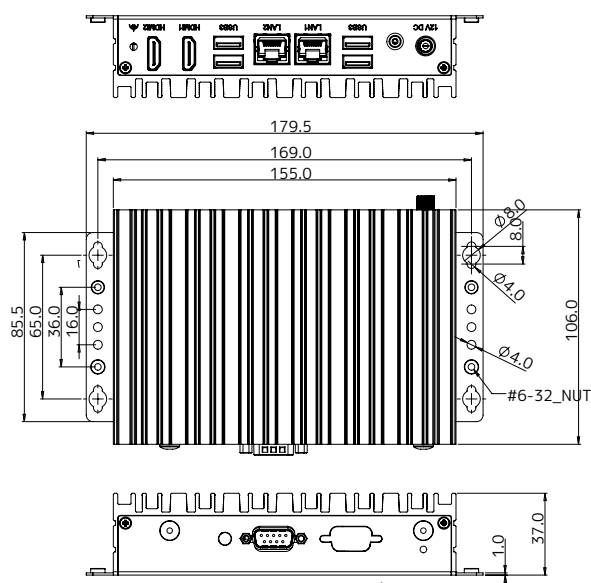
外形寸法 Neu-X102-N50 : 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)

重量 0.85 kg

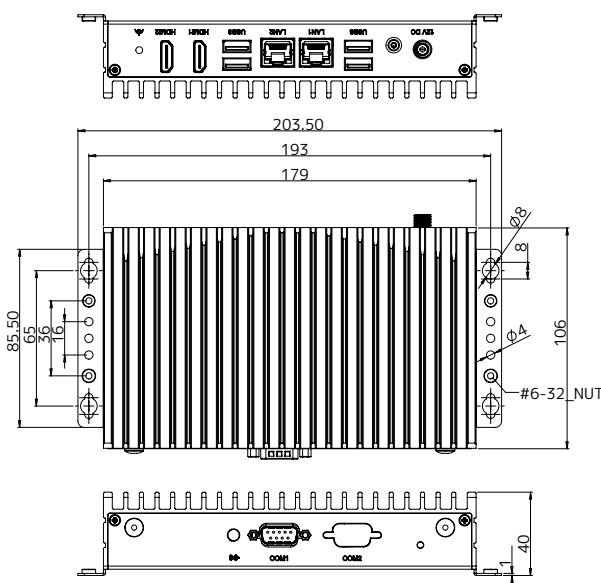
動作温度範囲 -5°C ~ 50°C

外形寸法 Neu-X102-N97/i3 : 180mm (W) x 106mm (D) x 40mm (H)

重量 0.9 kg



Neu-X102-N50 寸法



Neu-X102-N97/-i3 寸法



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X300-H310

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ

Neu-X300 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能なハイパフォーマンスなスマートシティコントローラです。ソケットタイプの第 8 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載可能。Core™ i7 から Celeron® まで目的に合わせて選択いただけます。



Neu-X300-H310



Neu-X300 背面

CPUタイプ：
第8世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)

- Intel® H310, Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4

- HDMI2.0 x 2, Audio-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- 12V DC / 96W AC アダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 55mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C

Neu-X303

第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ

SoC でソケットタイプ、第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載した Neu-X303 シリーズのエッジコンピューティングシステムは、非常にリッチなマルチメディアコンテンツや AI 処理を扱うことができます。Intel® Iris® Xe グラフィックスによる強力なグラフィックスは、4K の再生やコンテンツ制作など圧倒的なグラフィックを提供します。



Neu-X303



Neu-X303 背面

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (15W)
搭載可能CPU：
i3-1215UL (6 Core 2P4E, 8スレッド)
i5-1235UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i5-1245UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1255UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1265UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)

- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB
- LAN x 2, USB3.2 x 4

- HDMI2.1 x 1, DisplayPort x 1, USB type-C x 2 (ビデオ出力)
- M.2 x 1 (SSD)
- 12V DC / 120W AC アダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 150mm (D) x 60mm (H)

重量 1.9 kg

動作温度範囲 0 ~ 50°C

Neu-X304-H610/Neu-X304-Q670

IoT エッジ向け第 12 世代 Intel プロセッサ搭載

新型 CPU を搭載可能な Neu-X304 システムは、新時代の AI とビジュアルエッジコンピューティングの性能と効率の融合を提供し、ヘルスケアサービス、公共交通機関の監視、デジタル教育システム、AI 認識、データセンター・クラウドコンピューティングなど、産業における多目的なアプリケーションをサポートします。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X304-H610

Neu-X304-Q670 もラインナップ！

- ・ワイドレンジ（12～24V DC）入力
- ・Intel® AMT（インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー）対応



Neu-X304-H610 背面

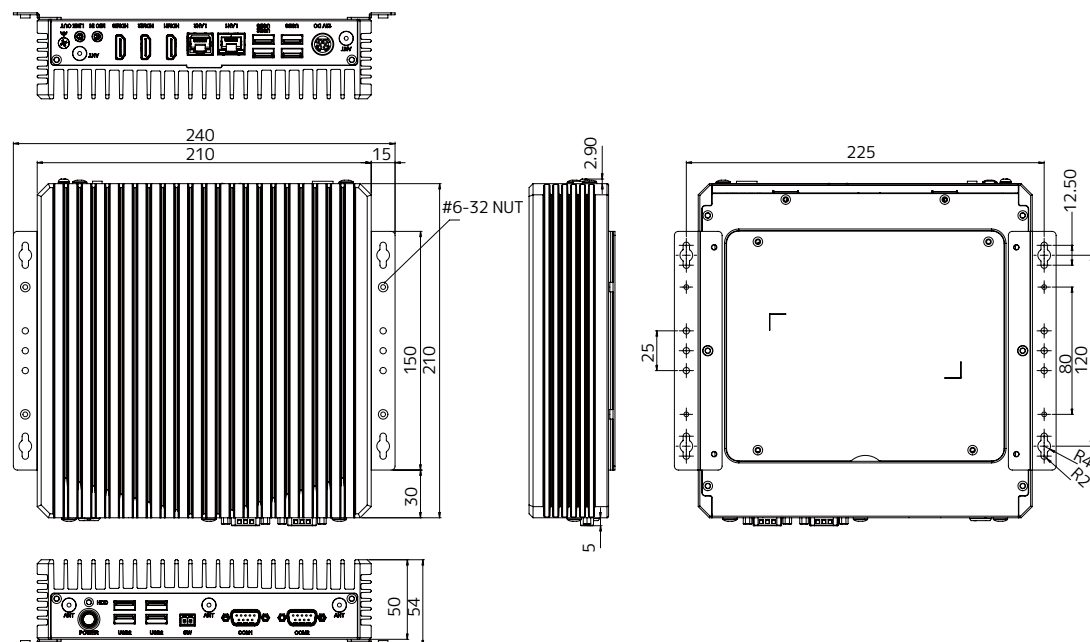
- ・Intel® PCH H610E
- ・Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- ・DDR5 SO-DIMMスロット x 2 最大64GB
- ・RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- ・USB3.2 x 3, USB2.0 x 5

- ・HDMI 2.0 x 3, LVDS x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- ・M.2 x 1 (SSD)
- ・M.2 x 1 (LTE), Micro-SIMスロット x 1
- ・リモートスイッチ端子 x 1
- ・12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 210mm (W) x 210mm (D) x 50mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C～45°C



NDiS B338

Intel® Celeron® J6412 プロセッサ搭載 広温度範囲対応スリム型ファンレス組み込みシステム



NDiS B338 は Intel® Celeron® J6412 CPU を搭載した省電力、広温度範囲対応のシステムです。COM ポート x4、HDMI x3、オーディオ端子を搭載しているため、高性能リテール機器のコントローラに適しており、小型のエンクロージャにより装置内の設置も容易です。2.5Gigabit LAN x1 を搭載し、高速通信も可能としました。



NDiS B338



NDiS B338 背面

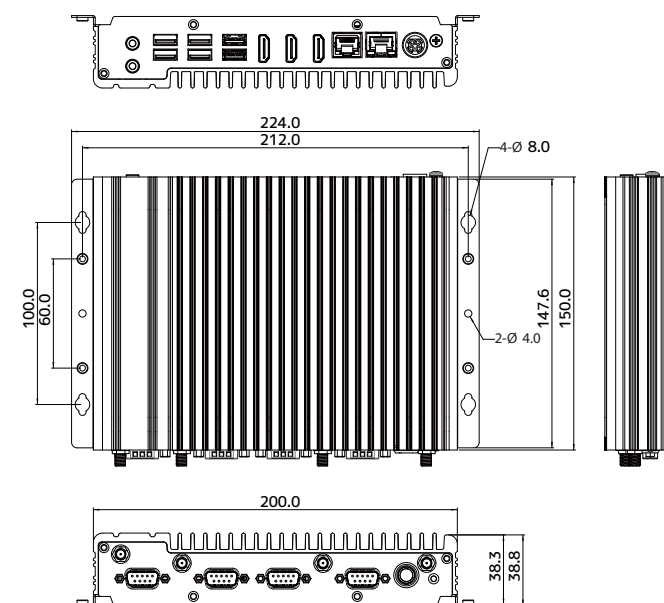
- ・Intel® Celeron® J6412 (Quad Core, 2.0GHz)
- ・Intel® UHD Graphics
- ・DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- ・RS232 x 3, RS232/422/485 x 1
- ・Gigabit LAN x 1, 2.5 Gigabit LAN x 1
- ・USB3.1 x 1, USB2.0 x 5

- ・HDMI2.0 x 3, Line-out x 1, Mic x 1
- ・M.2 x 1 (SSD)
- ・M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- ・Mini-PCle x 1
- ・12～24V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 224mm (W) x 150mm(D) x 40mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 -20°C～60°C



NDiS B339

エンベデッドスキューで長期供給 広温度範囲のファンレスコントローラ



Intel Atom® プロセッサ x7000RE シリーズ (コードネーム: Amston Lake) を搭載し x6000RE シリーズの 2 倍のコアと 2 倍のグラフィックスのベース周波数により、最適なエッジコンピューティングを実現します。Intel Atom® プロセッサ x7000RE シリーズは、電力効率に優れ、低消費電力 BGA パッケージに、ディープラーニング推論機能とグラフィックス実行ユニットを内蔵しています。ブロック電源端子や 12-24V のワイド DC 入力によりインダストリーフィールドで活躍可能です。

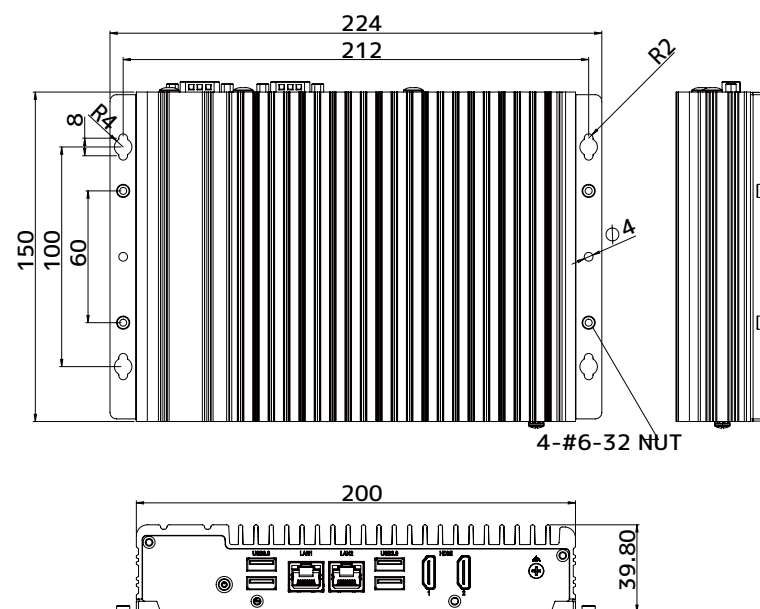


NDiS B339

CPUタイプ:
Intel Atom® x7000RE シリーズ プロセッサ
搭載可能CPU:
x7211RE (Dual Core, 1.0GHz)
x7213RE (Dual Core, 2.0GHz)
x7233RE (Quad Core, 1.5GHz)



NDiS B339 背面



- Intel® UHD Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大16GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1
- 2.5 Gigabit LAN x 2, USB3.2 x 4

- HDMI2.0 x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- 12~24V DC

外形寸法 224mm (W) x 150mm (D) x 40mm (H)

重量 1.4 kg

動作温度範囲 -20°C ~ 60°C

NDiS B360 / NDiS B360-DC

第 11 世代 Intel® 新型 Core™ プロセッサ搭載 TDP 15W / 10nm でより軽やかな動作性能

NDiS B360 は、第 11 世代 Intel® Core™ i3-1115G4E または Core™ i5-1145G7E プロセッサをオンボードで搭載した STB です。10 nm SuperFin により、グラフィック性能も一段とレベルアップし、Core i3 でも Celeron J3455 の約 3 倍の CPU パワーを有します。NDiS B360-DC は、配線が容易なブロック電源コネクタを採用し、DC 入力 12-24V をサポートします。同梱の入力コネクタにより装置内の組み込み等に使用可能です。



NDiS B360

- NDiS B360 :
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1
 - DC ジャック
 - 12V DC / 60W ACアダプタ付属
 - 200mm (W) x 133mm (D) x 36mm (H) 1.3 kg



NDiS B360 背面



NDiS B360-DC

- NDiS B360-DC :
- RS232 x 1
 - 3極端子ブロック
 - 24V DC入力 (ACアダプタ付属なし)
 - 200mm (W) x 133mm (D) x 36mm (H) 1.3 kg



NDiS B360-DC 背面

NDiS B360 シリーズ共通仕様

- NDiS B360-i3 :
- Intel® Core™ i3-1115G4E (Dual Core, 2.2GHz)
 - Intel® UHD Graphics
- NDiS B360-i5 :
- Intel® Core™ i5-1145G7E (Quad Core, 1.5GHz)
 - Intel® Iris® Xe Graphics

- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大32GB
- LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI2.0 x 1, DisplayPort++ x 1, Line-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)

外形寸法 200mm (W) x 133mm (D) x 36mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 NDiS B360 : -20°C ~ 60°C

NDiS B362

Intel® Core™ Ultra プロセッサ搭載 長期供給と NPU 搭載の AI コントローラ

15 年ぶりに大幅なアップデートにより登場した Intel® Core™ Ultra (Meteor Lake-U Intel4 プロセス) プロセッサをオンボード。一新されたプロセッサには、CPU、NPU、GPU を搭載し、ハードウェア要件の高い、高速な AI 処理も CPU 内部の NPU (Intel AI Boost) によりサポートします。GPU は Intel Graphics 搭載。Performance Core x2 と Efficient Core x8、低電力 E Core x2 の 14 スレッドにより、従来のアプリケーションもシームレスな動作を可能としました。



マザーボード単体
ご提供可能 (X201)



CPUタイプ：
Intel® Core™ Ultra (Meteor Lake) プロセッサ (15W)
搭載可能CPU：
Core Ultra 5, 125U Core Ultra 5, 135U
Core Ultra 7, 155U Core Ultra 7, 165U
※135U/165U のみ Intel® AMTをサポート

- Intel® Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大96GB
- RS232/422/485 x 2
- Gigabit LAN x 1, 2.5 Gigabit LAN x 1

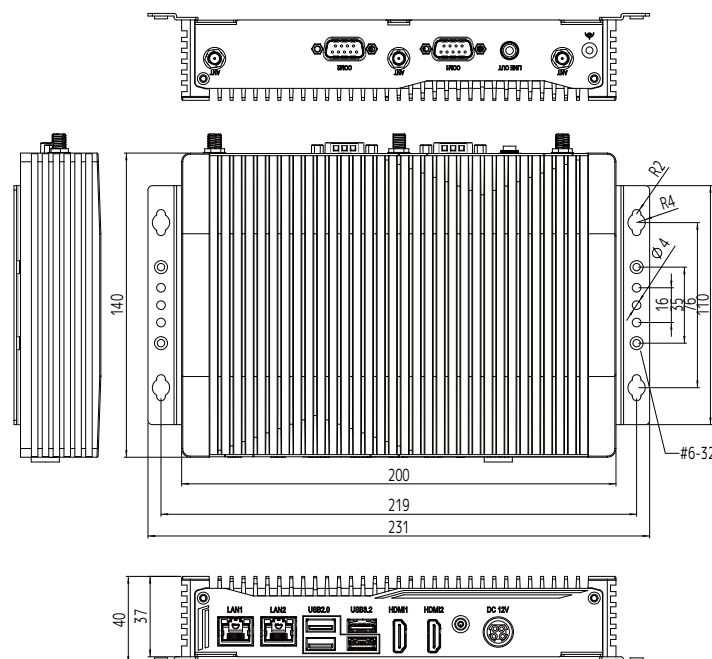
- USB3.2 x 1, USB2.0 x 3, HDMI x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- 12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 200mm (W) x 140mm(D) x 37mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 Core Ultra 5, 125U & 135U : 0°C ~ 60°C

動作温度範囲 Core Ultra 7 155U & 165U : 0°C ~ 55°C



NDiS B363

第二世代 Intel® Core™ Ultra (200U) プロセッサ搭載。低電力 + (NPU) AI

Intel® Core™ Ultra プロセッサの第二世代 (Arrow Lake-U) をオンボード。Meteor Lake-U (Intel® Core™ Ultra (100U)) に対して、Core の構成は同じですが動作クロックが向上しました。Performance Core x2 と Efficient Core x8、低電力 E Core x2 の 12 Core 構成で、さらに電力効率が向上、動作温度範囲も広く、使用環境が広範囲になりました。12-24V のワイド DC 入力やブロック電源コネクタなど、インダストリーフィールドでも十分使用可能です。AI 搭載のロボットコントローラから工作機械まで小型ながら高性能な AI 処理を可能としました。



CPUタイプ：
Intel® Core™ Ultra (Series2)(15W)
搭載可能CPU：
Core Ultra 5, 225U Core Ultra 5, 235U
Core Ultra 7, 255U Core Ultra 7, 265U
※265U/235U のみ Intel® AMTをサポート

- Intel® Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大96GB
- RS232/422/485 x 2
- Gigabit LAN x 1, 2.5 Gigabit LAN x 1

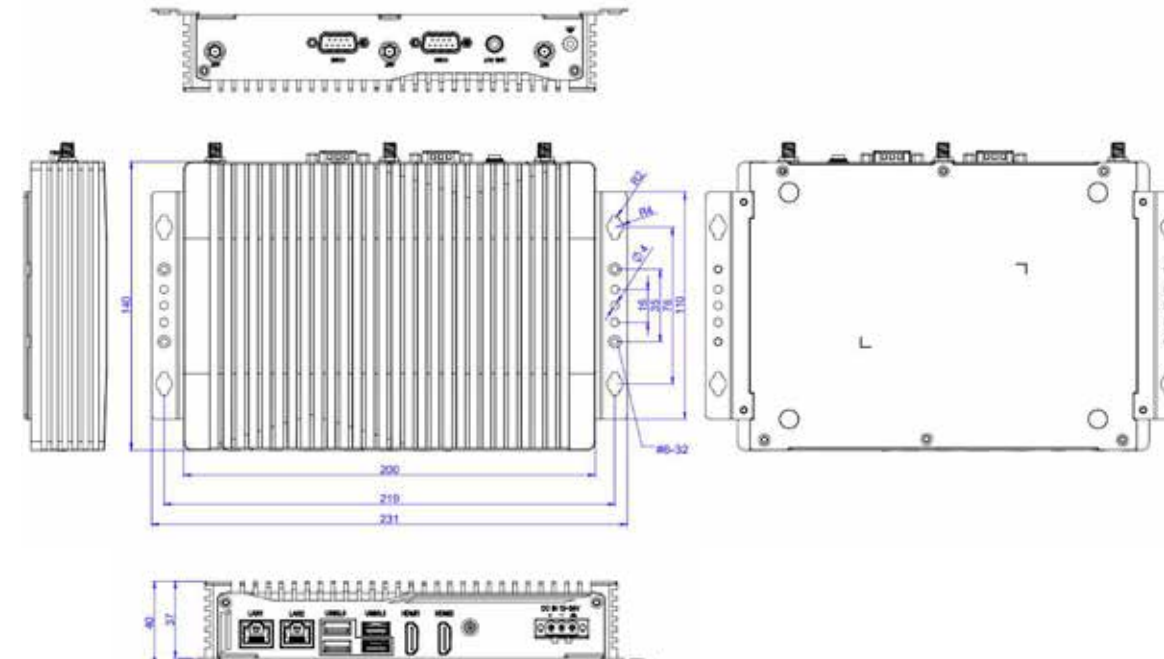
- USB3.2 x 1, USB2.0 x 3, HDMI 2.0 x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- 12~24V DC

外形寸法 200mm (W) x 140mm(D) x 37mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 Core Ultra 5 : 0°C ~ 60°C

動作温度範囲 Core Ultra 7 : 0°C ~ 55°C



NDiS B561 / NDiS B561-PoE

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 広温度対応 屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561 ファンレス・ビジュアル・エッジ・コンピュータは、強力なマルチメディア・コンテンツを扱うことができ、-20～60℃の幅広い動作温度範囲に対応します。3つの独立ディスプレイ出力で最大 8K@60Hz の出力が可能で、豊富な接続機能を備えています。PoE ポート x2 を含む LAN ポート x3 の NDiS B561-PoE（動作温度範囲 0℃～40℃）もラインナップしました。



NDiS B561

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

NDiS B561：
• LAN x 3
• 12~24V DC入力
• 12V DC / 120W ACアダプタ付属

NDiS B561-PoE：
• LAN x 1, LAN (PoE) x 2
• 24V DC入力
• 24V DC / 180W ACアダプタ付属

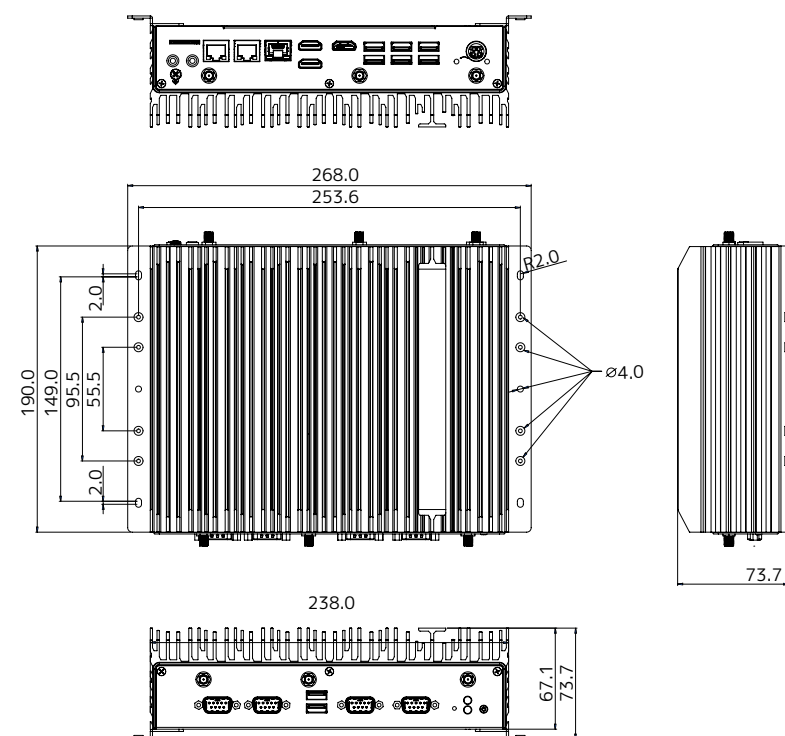
- Intel® Q670E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, USB3.2 x 8
- HDMI2.0 x 2, HDMI2.1 x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1

外形寸法 238mm (W) x 190mm (D) x 68mm (H)

重量 4.0kg

動作温度範囲 NDiS B561： -20℃～60℃

動作温度範囲 NDiS B561-PoE： 0℃～40℃



NDiS B561 背面

NDiS B561S

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561S は、NDiS B561 と同じマザーボードにバリューなチップセットを搭載し、低価格を実現しました。スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0℃～50℃と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。



NDiS B561S

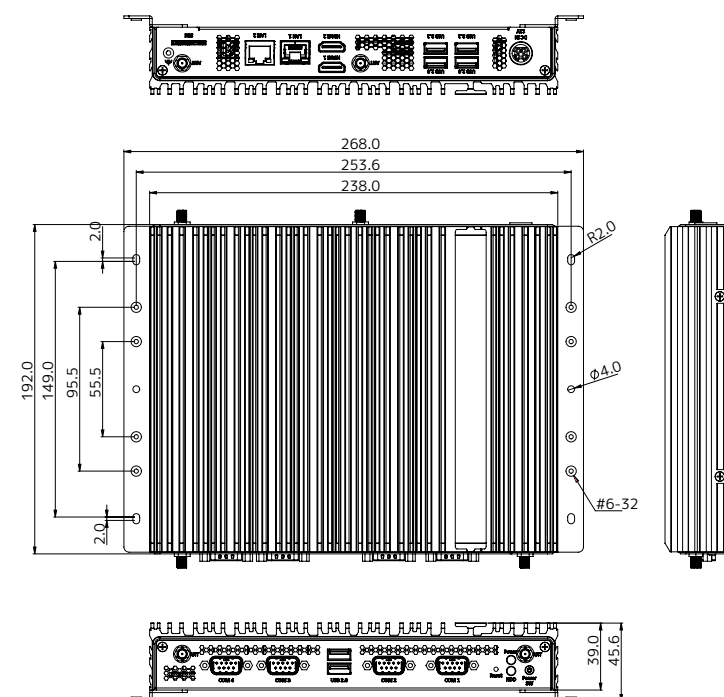
CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

- Intel® H610E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.2 x 2, USB2.0 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- 12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 238mm (W) x 190mm(D) x 39mm (H)

重量 3.0 kg

動作温度範囲 0℃～50℃



NDiS B561S 背面

AIEdge-X[®] 80 シリーズ

NVIDIA[®] Jetson Orin[™] NX を搭載したエッジ AI コンピュータ

NVIDIA



AI-Edge-X[®]80 は NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU Jetson Orin NX を搭載したエッジ AI コンピュータで、最大 100TOPS を実現しました。-20℃ -70℃のワイドな動作温度範囲。LAN x4 やブロック端子による 24V 電源入力など、リテールはもとよりインダストリーやファクトリーなどの組み込み機器として、様々な分野の AI 要件をサポートします。



AIEdge-X[®]80-NX8:
NVIDIA[®] Jetson Orin[™] NX 8GB, 70TOPS, 8GB LPDDR5
AIEdge-X[®]80-NX16:
NVIDIA[®] Jetson Orin[™] NX 16GB, 100TOPS, 16GB LPDDR5

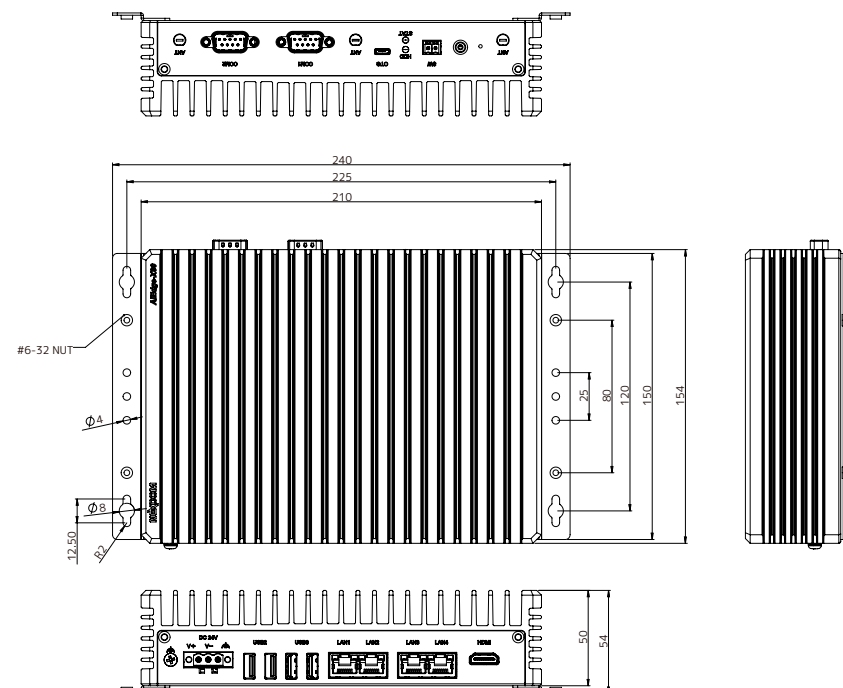
- M.2 128GB SSD 搭載済み
- 1024-core NVIDIA Ampere GPU (32 Tensor Cores)

- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 4
- USB3.2 x 2, USB2.0 x 2, USB OTG x 1
- HDMI1.4 x 1
- M.2 x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- Mini-PCIeスロット x 1
- 3極端子ブロック 24V DC入力

外形寸法 240mm (W) x 154mm (D) x 54mm (H)

重量 2.1kg

動作温度範囲 -20 ~ 70℃



AIEdge-X[®] 310

最新高性能 GPU に対応した第 12 世代 Intel[®] Core[™] プロセッサ対応機

NVIDIA

高性能 AI を実現するには、GPU カードが必要になります。大型のエンクロージャでは設置場所が限られるため、2.5 スロット幅の GPU が搭載可能な比較的小型の薄型のエンクロージャとしてコンパクトにまとめた新型の AIEdge です。850W 電源の搭載により、NVIDIA[®] GeForce RTX[™] 4090 も搭載可能です (NVIDIA GeForce 5xxx シリーズはご相談ください)。TDP 65W までの CPU をサポートします。



Fan

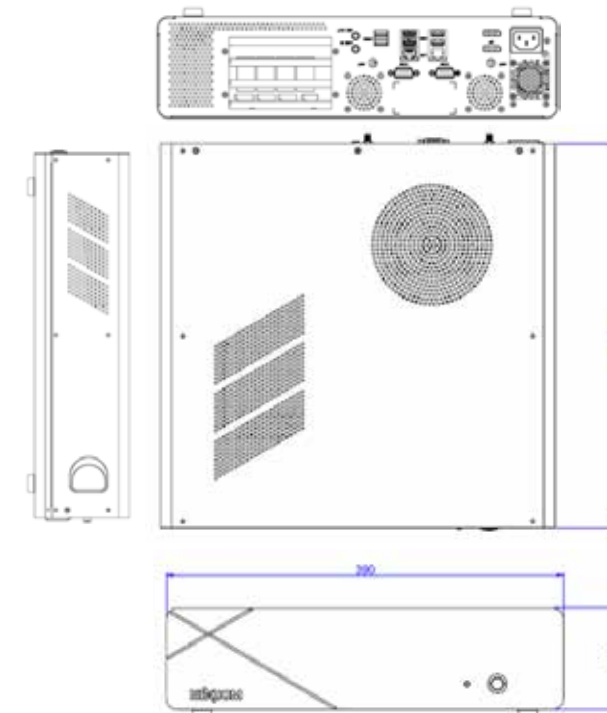
- Intel[®] H610E
- Intel[®] Iris[®] Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 4, USB2.0 x 2

- DisplayPort 1.4 x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- 2.5インチベイ x 2, M.2 x 1 (SSD)
- PCIe(x16) スロット x 1
- 850W電源搭載

外形寸法 390mm (W) x 380mm (D) x 99mm (H)

重量 6.7 kg

動作温度範囲 0 ~ 45℃



リテール向け産業用グレードタッチパネルコンピュータ XPPC シリーズ

XPPC シリーズ、リテールマーケット向けに開発した、ワイド液晶、ファンレス、静電タッチ式のパネルコンピュータです。VESA やクランプによるマウントにより縦横問わずフレキシブルな設置が可能です。フロントは IP65 に対応し防水対策を施しています。一部の仕様変更や ODM にも対応いたします。

XPPC 10N97 シリーズ

Neu-X102-N97 共通のマザーボードを液晶パネルの背面に取り付けた、高性能なファンレス静電容量 (P-CAP) タッチパネル PC です。10 インチ (16:10) と 16 インチ (16:9) が選択可能です。

XPPC 10N97シリーズの特徴

- Intel® Processor N97 (Quad Core)
- Intel® UHD graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 (最大 16GB)
- M.2 2242 x 1 (SSD), mSATA x 1
- Mini-PCIeスロット x 1
- HDMI x 1, LAN x 2
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 1
- USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 2
- 温度条件(動作時): 0℃~40℃
- 12V DC 入力



XPPC 10-10N97

10.1 インチ 16 : 10 1280 x 800
261mm (W) x 179mm (D) x 48mm (H) 1.7 kg
VESA マウント : 75mm x 75mm



XPPC シリーズ共通仕様

背面には VESA マウントスクリーホールや専用の取付金具を使用して、壁や機器などに固定することができます。LAN x2 ポートを使用し、安定した高速通信が可能です。またフロント部分は IP65 に対応し、防水対策も施しています。

- マルチタッチ10点
投影型静電容量方式 (P-CAP)
- 防塵防滴規格 IP65準拠(フロント部のみ)
- ACアダプタ, ACパワーコード付属

選べる3つの
マウント方式



写真は 10 インチタイプです。
他のパネルシリーズも 3 つの
方式に対応しています。



XPPC 16-10N97

15.6 インチ 16 : 9 1920 x 1080
383mm (W) x 252mm (D) x 52mm (H) 2.9 kg
VESA マウント : 100mm x 100mm



XPPC 100 シリーズ

Neu-X スマートシティコントローラのマザーボードを、液晶パネルの背面に取り付けたタッチパネル PC です。CPU は Quad Core Celeron® J3455 を搭載、最大 8GB のメモリにより、端末機としては十分なパフォーマンスを発揮します。

XPPC 100シリーズの特徴

- Intel® Celeron® J3455
- Intel® HD Graphics
- DDR3L SO-DIMM スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD SATA)
- HDMI x 1, Line-out x 1, LAN x 2
- RS232/422/485 x 1
- USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 (XPPC16-101のみ)
- LTE 対応 (Mini-PCIe スロット x 1), SIMスロット x 1
- 温度条件(動作時): 0℃~50℃
- XPPC10-100: 12V DC 入力
XPPC16-101 / XPPC 22-100A / XPPC 24-100A: 19V DC 入力



XPPC10-100

10.1 インチ 16 : 10 1280 x 800
261mm (W) x 179mm (D) x 45mm (H) 2.0 kg
VESA マウント: 75mm x 75mm



XPPC16-101

15.6 インチ 16 : 9 1920 x 1080
383mm (W) x 252mm (D) x 52mm (H) 3.0 kg
VESA マウント: 100mm x 100mm



XPPC 22-100A

21.5 インチ 16 : 9 1920 x 1080
521mm (W) x 316mm (D) x 54mm (H) 5.0 kg
VESA マウント: 100mm x 100mm



XPPC 24-100A

23.8 インチ 16 : 9 1920 x 1080
558mm (W) x 337mm (D) x 56mm (H) 6.0 kg
VESA マウント: 100mm x 100mm

リテール向け産業用グレードタッチパネルコンピュータ HPPC シリーズ

HPPC100 シリーズは、エンベデッド SKU の Intel Atom® x7211RE と、4:3 の高輝度液晶パネルを搭載した、屋内外を問わないパネルコンピュータです。4:3 の静電容量タッチ方式の製品は少なく、従来のシステムのパネル部分の置き換えに適しています。ワイドスクリーンに置き換えるには、ソフトウェアの変更や、設置場所の制限など、問題が多く発生しますので比較的容易に更新可能です。動作保証温度は、-20℃~60℃とワイドレンジを実現したため、屋外に設置される自動販売機や精算・両替機・宅配ロッカーなど様々な用途に大きな変更なく導入可能です。周囲の明るさに合わせて輝度をコントロールすることも可能です。12 インチと 15 インチのラインナップです。

HPPC 100 シリーズ

HPPC 100シリーズの特徴

- Intel Atom® x 7211RE
- Intel® UHD Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- Mini-PCIe スロット x 1
- HDMI x 1, Line-out x 1, LAN x 2
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 1
- USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2
- 温度条件(動作時): -20℃~60℃
- 12~24V DC 入力



HPPC12-10X7211

12.1 インチ 4 : 3 1024 x 768
294mm (W) x 248mm (D) x 53mm (H) 2.0 kg
VESA マウント: 100mm x 100mm



HPPC15-10X7211

15 インチ 4 : 3 1024 x 768
352mm (W) x 296mm (D) x 59mm (H) 5.0 kg
VESA マウント: 100mm x 100mm

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から 1台より受注 最低発注数は、システム1台より承ります。	面倒な組立てはお任せ アセンブリサービス ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。	各種キッティング インストール・キッティング ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご希望のCDなどの添付品の同梱等、各種キッティング作業も承ります。
信頼性を高めます 出荷前検査の実施 出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。	安心の国内サポート 修理・技術サポート 修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。	貸出無料 評価機貸出 ネクスコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証（標準保証） 標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。（保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております）	国内での修理対応 ネクスコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。
センドバックによる受付 修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。	本社 (NEXCOM International) での修理対応 ネクスコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

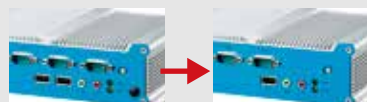
その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム ネクスコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiSシリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。 ※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。	USBでメモリブートし、簡単リカバリ リカバリ USB メモリ添付サービス 製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。出荷時に Windows イメージ USB メモリにリカバリして添付しますので、障害発生時に出荷時の状態に簡単に復旧することができます。また、お客様のアプリケーション等を含めたオリジナルのリカバリイメージを何回でも作成可能です。お客様でイメージを作成するパラゴンライト (USB メモリとパラゴンソフトウェアのみ) も低価格でご用意しています。 (※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。)	パラゴンライト 新登場
何回でも修理費無料！ 年8%とリーズナブル 2,3,4,5年間の選択可 1台から対応	【USB リカバリの資料】 NEXCOM テクニカルサポートページ カタログ・マニュアルダウンロード 	



PARAGON
SOFTWARE

カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キッティングサービス Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キッティングサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。	ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ BIOS のカスタマイズ (ロゴ表示・デフォルト値の変更) や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介させて頂きます。	ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作 ステッカーの製作は200枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。 
ODMソリューションその④ カラーチェンジ ケースのカラーチェンジは200台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。	ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。 	ODMソリューションその⑥ 各種認証取得 標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクスコム・ジャパンオリジナル ネクスコム IoT ソリューション **5G近日常対応！** 詳しくは お問合せ下さい

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE モジュール

SIMCom Wireless Solution社製

SIM7600JC-H-MPCleモジュール	
対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80℃

SIM7600JC-H-M2モジュール	
型式名	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80℃

LTE 通信専用アンテナ

メーカー	キャセイ・トライトック	
品名	1 ダイポールアンテナ	2 無指向性アンテナ
型名	JSK-4G-401	CTA-002-2m
外形寸法 (mm)	—	—
ケーブル長 (m)	—	2
動作温度	-40~70℃	
取付方法	本体に直付け 両面テープ	

ダイポールアンテナを取り付けた状態のNeu-X100

無指向性アンテナ